

業務提携を目的としたパッケージ製造子会社の譲渡に関する基本合意のお知らせ

トレックス・セミコンダクター株式会社(以下、トレックス 本社:東京都中央区)と、PANJIT INTERNATIONAL INC.(以下、PANJIT 本社:Kaohsiung City, Taiwan)との間で、当社の連結子会社である TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD(以下、TVS)について、業務提携を目的として当社が保有する持分の全部または一部を PANJIT に譲渡することを目的とする基本合意書を締結したことを発表しました。

TVS は当社の連結子会社として、当社製品のパッケージ製造工程(後工程)を展開しておりますが、半導体パッケージ技術は、日々劇的な進化を遂げており、次世代パッケージと呼ばれる高集積化や小型・薄型化、高放熱化などの技術が登場するなど、技術の高度化が進んでおり、今回の提携により、お互いが有する知見や技術などの経営資源を提供しあい、相互にシナジー効果を発揮することで、技術力や生産力、市場環境の変化への対応力を高め、中長期的な企業価値の向上が期待できます。

一方で、当社としましては、アナログ半導体技術の根幹である回路設計やプロセス開発とその製造工程に経営資源を振り向けることも可能となり、より強固に技術リソースの選択と集中を進めることができるようになります。

・トレックス・セミコンダクター株式会社 代表取締役社長執行役員 木村 岳史のコメント

「半導体業界においては、技術は日進月歩で進化しています。この変化に対応するためには、当社だけでなく、今や世界の半導体技術の最先端である台湾におけるディスクリートのリーディングカンパニーである PANJIT INTERNATIONAL INC.と後工程において、お互いが有する知見や技術などの経営資源を提供しあうことで、企業価値を高めることができると確信しています。」

・PANJIT INTERNATIONAL INC. Chairman of the Board, President Fang, Ming-Ching のコメント

「今般、日本のトップ半導体メーカーである TOREX SEMICONDUCTOR LTD. と連携することとなりましたことを嬉しく思います。これはパンジットが従来進めてきたワールドワイド戦略の一環であり、同社の一部製造資源を共有することにより、当社顧客への対応が一層効率的になりますし、二社にとって更なる発展及び明るい未来が築けると信じております。」

トレックス・セミコンダクター株式会社 ホームページ <https://www.torex.co.jp/>

PANJIT INTERNATIONAL INC. ホームページ <https://www.panjit.com.tw/en>